

NDT Systems 社

Bondscope 3100 : 超音波ボンドテスター

多目的用途に対応する6種類の検査手法をご提供します！

Bondscope3100 は、多重積層構造および接合構造材について、層間剥離、接着不良、小孔、異物、衝撃損傷、液体進入などを検出することができます。 ガラス繊維複合材、炭素繊維複合材、ハニカム材、金属同士の結合材等を含め、複合材検査市場における最も有能な検査機器です。

当社では、当該製品を含めた高性能機器を始め、簡易な超音波探傷器まで幅広く製品を取り揃えております。



主な仕様

本体サイズ (mm)	: 140 (W) x 74(D) x 235(L)
重量 (kg)バッテリー含	: 2.26 (5.0 lbs)
ディスプレイサイズ	: フル 240 x 320 ピクセル 1/4-VGA
周波数範囲	: 250 Hz - 1.5 MHz
アプリケーション例	: グラスファイバー複合材 多層ラミネート材 ハニカム構造材 など

検査の基本的種類と特性

発・受信(P/C) : 多重積層構造、接着構造、サンドイッチ構造物検査に適します。

接触触媒を使用せず、乾燥した状態で0.5インチ以上の傷検知を簡易に行えます。

反響モード : 多重積層構造、接着構造、サンドイッチ構造物検査に適します。

接触触媒を用いる必要がありますが、より小さい傷を検知出来るとともに、多重積層構造物のどこに傷があるか確認することが出来ます。

機械的抵抗分析: 接触触媒が不要であり、金属同士の結合材料検査に適します。

浸透能力は劣りますが、荒い表面や湾曲した表面に適し、欠陥の正確な場所を特定します。

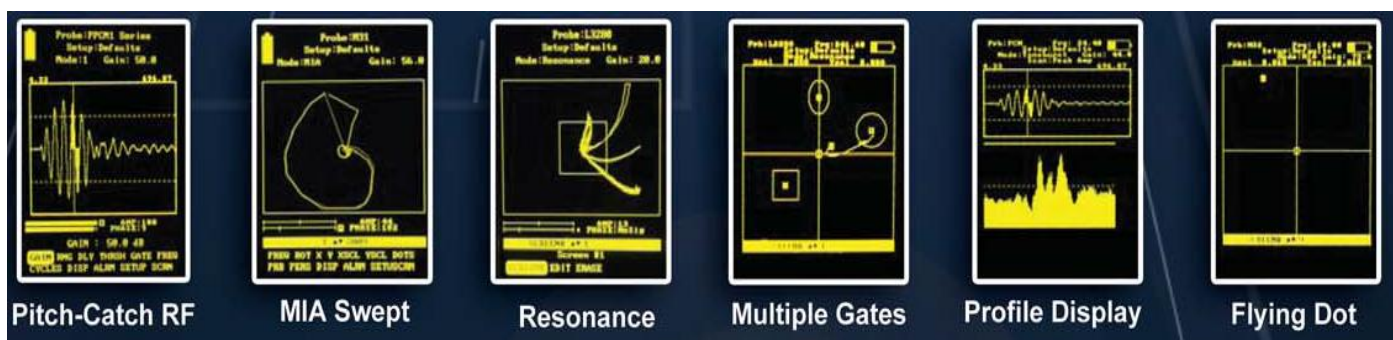
日本販売代理店

株式会社 祥インターナショナル

連絡先 : sho_koho@shoint.co.jp

<http://www.shoint.co.jp/>

6 種検査表示例—Bondscape 3100



SPECIFICATIONS

Modes	Resonance (RF & flying dot); pitch catch (tone burst - adjustable frequency, cycles and altitude) high energy pulsed mode, swept frequency; mechanical impedance analysis (MIA) fixed and swept frequency
Display	240 x 320 pixels, quarter-VGA, 5.7"(14.4mm) diagonal high-bright EL
Probe connector	standard 11-pin Fischer & 8-pin Lemo
Frequency range	250Hz-1.5MHz probe and setup specific
Operating temperature	15 F to 105 F (-10 C to +40 C)
Alarms	box, polar and up to 8 individual and individually sizeable "ring gates" centered at stored reference dot locations in impedance plane operation. Positive or negative operation
Storage	100 setups and 250 screens with real-time date and time stamp
Dimensions	9.25"H x 5.5"W x 2.9"D (235x140x74mm)
Weight	5-lb (2.26kg) including battery

上記仕様は予告なしに変更される場合があります。

製品詳細情報 <http://www.ndt-systems.com/bondscope-3100>

NDT Systems社、製品ラインアップにつきましては <http://www.ndt-systems.com/> をご参照ください。